

B072 Disclosure 信息披露

(上接B071版)

(5) 存货总金额下降却大幅提高存货、库存商品减值计提比例的原因

2023年末和2024年末，公司对存货计提的跌价准备按照存货情况或跌价考虑因素分类的情况如下所示：

库龄/预计/跌价考虑因素	计价的跌价准备	占比
2024年末		
库龄超过2年部分旧型产品及其原材料等	9,537.45	59.99%
库存余额占当年的10%以上的产品	4,256.25	29.98%
小部分市场价格下降的产品	1,460.68	10.26%
合计	14,254.38	100.00%
2023年末		
库龄超过2年部分旧型产品及其原材料等	3,374.70	47.73%
库存余额占当年的10%以上的产品	3,695.64	52.27%
小部分市场价格下降的产品	-	-
合计	7,070.73	100.00%

由上表可知，公司对存货跌价准备主要与下列因素有关：

①产品导致存货部分产品滞销超过两年：

芯片设计企业尤其是平台设计企业不仅需要芯片本身的设计开发，还需要支撑下游客户的各类型终端应用，为其提供完整的解决方案。在消费类电子产品的智能联网设备领域，由于其终端产品更新速度快，公司要及时根据终端市场发展趋势及客户需求调整方向，快速实现技术

和产品迭代，才能不断推出产品在下游市场的应用和竞争力。

2024年，公司业务重心转向终端芯片等多模产品，放缓了Wi-Fi、蓝牙和IPO芯片等非高频类产品的迭代进程，部分存货库龄目前已经超过两年。截至2024年末，该部分存货计提的跌价准备为8,537.45万元，较同期上升1,626.65万元，其中存货跌价准备金额上升14,254.38万元的93.98%，系本公司年度计提跌价准备的主要组成部分。

②部分产品备货较多，去库存速度较慢：

基于提高下游客户粘性的考虑，公司就一些老型号芯片产品，为客户准备一定数量库存。

受下游市场需求变化及成本影响，公司对客户进行采购量不及时，导致本年度该等芯片产品的去库存速度较慢，部分型号产品无法实现销售。公司结合市场最新情况，计划以较低的价格销售剩余芯片产品，以快速回笼资金。

于报告期末，公司对近期售价为基础，预计存货可变现净值，进行存货跌价测试，计提了该部分存货的跌价准备，金额为4,256.25万元。目前，公司对该等芯片产品的销售策略以库存为主，并将存货跌价准备（2年内及以后）部分存货跌价准备，上述情况对公司未来业绩的影响较小。

③部分产品市场价格下降：

面对同行价格竞争，公司采取降价策略抢占市场份额的情况下，公司不得已同时增加进价，调整了小部分芯片产品的市场价格。

该类型号占公司产品种类的比例较小，对公司业绩影响有限。

于报告期末，公司以近期售价为基础，预计存货可变现净值，进行存货跌价测试，计提了该部分存货的跌价准备，金额为1,460.68万元。随着公司产品不断到客户验证，产品矩阵不断完善丰富，公司其他高毛利的产品有望提升利润率。

综上，公司结合市场需求，整体销售、销售计划与销售策略以及报告期后的销售情况，对2024年末存货充分计提了存货跌价准备，存货总金额下降但大幅提高存货跌价准备，主要与产业链产品布局、优化库存水平及短期销售策略有关，对公司未来业绩影响有限。

④三（税）本年委托加工物资余额增长的原因：

2024年末与2023年末，公司存货的具体明细情况对比如下表所示：

项目	2024年末		2023年末	
	账面金额	账面余额占比	账面金额	账面余额占比
原材料	13,636.78	9.13%	18,977.68	12.17%
库存商品	38,368.77	26.57%	43,161.66	28.06%
合同履约成本	3,837.23	2.57%	9,766.68	6.29%
委托加工物资	86,990.54	59.60%	74,593.33	48.10%
发出商品	4,473.79	3.00%	8,340.00	5.28%
合计	140,316.21	100.00%	106,064.14	100.00%

与2024年相比，公司委托加工物资余额增长，原因是委托加工物资的存管、管理与盘点进度：

1、本年委托加工物资余额增长的原因

2024年度及2025年第一季度，公司委托加工物资流转变动情况如下表所示：

项目	2024年末		2023年末	
	期初余额	由原材料等转入	销转为产成品/发出商品	期末余额
第一季度	74,593.33	49,189.34	60,993.60	62,826.74
第二季度	62,826.74	67,112.28	51,869.58	68,073.44
第三季度	68,073.44	48,782.72	60,270.31	76,288.65
第四季度	76,288.65	68,800.73	66,074.07	88,990.54
2025年 第一季度	88,990.54	64,095.28	60,696.48	90,308.84

公司芯片产品设备周期一般为一个月，各季度末及年末度委托加工物资的期末余额波动主要受公司对芯片产品的生产进度影响。2024年，公司生产与市场规模扩大，与2023年度同期数据相比增长26.43%和44.06%，生产规模持续扩大系委托加工物资余额增长的主要原因。

2024年，通过芯片下游市场回暖，公司提高了生产规模，导致2024年末委托加工物资余额有所上升。

针对委托加工物资中可能存在的因降价出售而导致毛利率为负的情况，公司在年末对部分委托加工物资计提了跌价准备，具体情况参见“二、2、存货跌价准备的测算过程”。

综上，本公司年末未委托加工物资余额增长与公司生产规模扩大有关。与公司生产相关的核查准确，不存在本期及往期结转委托加工物资相关资产准备的情况。

2、原材料、产成品余额下降的原因

2024年及2025年第一季度，公司原材料、产成品的期末余额如下：

项目	2024年末		2023年末	
	期初余额	由原材料等转入	销转为产成品/发出商品	期末余额
原材料	16,594.99	12,376.00	13,013.00	13,636.78
产成品	54,665.99	49,579.42	43,724.76	38,368.77
(按批次统计)	140,316.21	100.00%	106,064.14	100.00%

与2024年相比，公司委托加工物资余额增长，原因是委托加工物资的存管、管理与盘点进度：

1、本年委托加工物资余额增长的原因

2024年度及2025年第一季度，公司委托加工物资流转变动情况如下表所示：

项目	2024年末		2023年末	
	期初余额	由原材料等转入	销转为产成品/发出商品	期末余额
第一季度	74,593.33	49,189.34	60,993.60	62,826.74
第二季度	62,826.74	67,112.28	51,869.58	68,073.44
第三季度	68,073.44	48,782.72	60,270.31	76,288.65
第四季度	76,288.65	68,800.73	66,074.07	88,990.54
2025年 第一季度	88,990.54	64,095.28	60,696.48	90,308.84

公司芯片产品设备周期一般为一个月，各季度末及年末度委托加工物资的期末余额波动主要受公司对芯片产品的生产进度影响。2024年，公司生产与市场规模扩大，与2023年度同期数据相比增长26.43%和44.06%，生产规模持续扩大系委托加工物资余额增长的主要原因。

2024年，通过芯片下游市场回暖，公司提高了生产规模，导致2024年末委托加工物资余额有所上升。

针对委托加工物资中可能存在的因降价出售而导致毛利率为负的情况，公司在年末对部分委托加工物资计提了跌价准备，具体情况参见“二、2、存货跌价准备的测算过程”。

综上，本公司年末未委托加工物资余额增长与公司生产规模扩大有关。与公司生产相关的核查准确，不存在本期及往期结转委托加工物资相关资产准备的情况。

3、原材料、产成品余额下降的原因

2024年及2025年第一季度，公司原材料、产成品的期末余额如下：

项目	2024年末		2023年末	
	期初余额	由原材料等转入	销转为产成品/发出商品	期末余额
原材料	16,594.99	12,376.00	13,013.00	13,636.78
产成品	54,665.99	49,579.42	43,724.76	38,368.77
(按批次统计)	140,316.21	100.00%	106,064.14	100.00%

与2024年相比，公司委托加工物资余额增长，原因是委托加工物资的存管、管理与盘点进度：

1、本年委托加工物资余额增长的原因

2024年度及2025年第一季度，公司委托加工物资流转变动情况如下表所示：

项目	2024年末		2023年末	
	期初余额	由原材料等转入	销转为产成品/发出商品	期末余额
第一季度	74,593.33	49,189.34	60,993.60	62,826.74
第二季度	62,826.74	67,112.28	51,869.58	68,073.44
第三季度	68,073.44	48,782.72	60,270.31	76,288.65
第四季度	76,288.65	68,800.73	66,074.07	88,990.54
2025年 第一季度	88,990.54	64,095.28	60,696.48	90,308.84

公司芯片产品设备周期一般为一个月，各季度末及年末度委托加工物资的期末余额波动主要受公司对芯片产品的生产进度影响。2024年，公司生产与市场规模扩大，与2023年度同期数据相比增长26.43%和44.06%，生产规模持续扩大系委托加工物资余额增长的主要原因。

2024年，通过芯片下游市场回暖，公司提高了生产规模，导致2024年末委托加工物资余额有所上升。

针对委托加工物资中可能存在的因降价出售而导致毛利率为负的情况，公司在年末对部分委托加工物资计提了跌价准备，具体情况参见“二、2、存货跌价准备的测算过程”。